

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金海通”）于2023年03月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本、企业类型情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股。本次发行后，公司注册资本由人民币4,500.00万元变更为6,000.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年2月24日出具了容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》。

鉴于公司股票已于2023年03月03日在上海证券交易所主板上市，企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据公司2021年第二次临时股东大会于2021年05月15日审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关事宜，包括但不限于“根据本次发行并上市的具体情况修改完善《公司章程（草案）》及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜”。

董事会有权根据股东大会授权在本次股票发行完成后根据中国证监会批准

的结果，按股东大会通过的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程（草案）》修改公司章程相应条款，并办理公司工商注册变更登记事宜等相关事项。

结合上述变更注册资本、企业类型的实际情况，并根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日，在上海证券交易所上市（以下简称“证券交易所”）。	第三条 公司于2023年1月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2023年3月3日，在上海证券交易所上市（以下简称“证券交易所”）。
第五条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第五条 公司注册资本为人民币6,000万元。
第十九条 公司股份总数为【 】股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为6,000万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

三、授权办理工商变更登记情况

公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023年03月24日